

研削加工、工具製造、先進パワー半導体ウエハ加工の最新技術集結！

専門展示会 千葉・幕張メッセで3/5開幕

産経新聞社と日本工業出版は、研削加工技術と工具製造技術に特化した展示会「Grinding Technology Japan (GTJ) 2025」と先進パワー半導体ウエハ加工技術に関する展示会「SiC、GaN 加工技術展 (SiC、GaN) 2025」を3月5日(水)～7日(金)、千葉市美浜区の幕張メッセで同時開催します。

【GTJ公式サイト】<https://gtj-expo.jp/>

【SiC、GaN公式サイト】<https://sicgan-expo.jp/>



GTJ



SiC、GaN



SiC, GaN加工技術展 2025

GTJは2019年にスタート。加工に課題を抱える技術者などが毎回多数来場し、質の高い技術相談や情報交換、商談ができる場として高い評価を受けています。今回も国内外のメーカー、ディーラーが出展。研削加工、工具製造技術を支える工作機械や砥石(といし)、計測、周辺機器を紹介します。

さらに今年からはSiC、GaNを新たに開催します。カーボンニュートラル社会の実現に向けて大量の先進パワー半導体が必要になる中、先進パワー半導体材料は非常に硬く、高い加工コストが問題となっています。本展では、最新の技術と知識でこうした課題に最良の回答を提供します。

このほか両展示会の基調講演、併催イベントなどは公式サイトをご覧ください。

【日時】3月5日(水)～7日(金) 午前10時～午後5時

【会場】幕張メッセ8ホール(千葉市美浜区中瀬2-1)

【入場料】無料(事前登録制)

【出展規模】

《GTJ》172社・団体・研究室、264小間(中国パビリオン22社、23小間含む)

《SiC、GaN》53社・団体・研究室、56小間(中国パビリオン5社、8小間含む)

【詳細、事前登録】公式サイトをご覧ください。定員になり次第締め切り。